



Europäisches Patentamt
European Patent Office
Office européen des brevets

Veröffentlichungsnummer:

**0 288 585
A1**

12

EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

Anmeldenummer: 87104367.5

Int. Cl. 4: H01H 1/02 , H01H 11/04 ,
B23K 1/20

Anmeldetag: 24.03.87

Veröffentlichungstag der Anmeldung:
02.11.88 Patentblatt 88/44

Benannte Vertragsstaaten:
AT BE CH DE FR GB LI NL SE

Anmelder: INOVAN GmbH & Co. KG Metalle
und Bauelemente
Industriestrasse 44
7534 Birkenfeld-Pforzheim(DE)

Erfinder: Herz, Konrad, Dr.
Rainstrasse 10
D-7534 Birkenfeld 1(DE)

Vertreter: Trappenberg, Hans
Postfach 1909
D-7500 Karlsruhe 1(DE)

Verfahren zum Erzeugen einer löt- oder schweisssfähigen Unterseite an Silber-MeO-Kontaktplättchen.

Aus Silber/MeO bestehende Kontaktplättchen können auf einen Kontaktträger nicht aufgelötet oder aufgeschweißt werden.

Um dies doch zu ermöglichen, wird vorgeschlagen, die Kontaktplättchen (3) oberflächlich mittels eines rasterförmig überstreichenden Laserstrahls (7) in reduzierenden Atmosphäre (4, 5) aufzuschmelzen, so daß sich eine einstückig mit dem Kontaktplättchenmaterial verbundene metalloxidfreie Schicht ergibt.

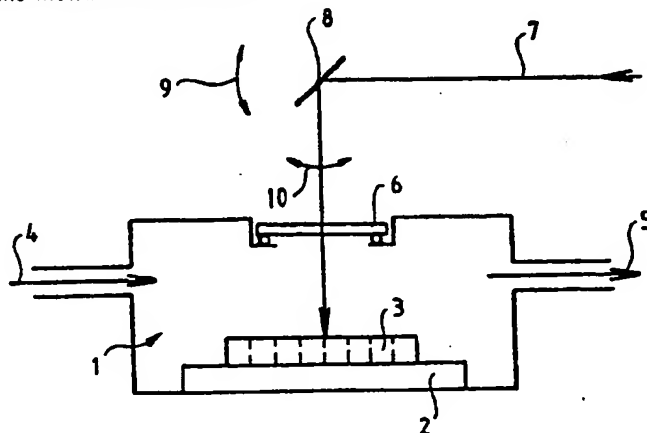


Fig. 1

Xerox Copy Centre

EP 0 288 585 A1

Verfahren zum Erzeugen einer löt- oder schweißfähigen Unterseite an Silber/MeO-Kontaktplättchen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Ausbilden einer löt- oder schweißfähigen Schicht auf der Rückseite (Unterseite) eines Silber-MeO-Kontaktplättchens mit Me-Anteilen, vorzugsweise aus Cadmium, Zinn, Zink, Kupfer, Wismut, Molybdän, Wolfram oder Indium, bei dem die MeO-Partikel faserförmig (spießig) ausgebildet sind und mit ihrer Faser-Längsrichtung etwa senkrecht zur Kontakt-oberfläche liegen.

Moderne elektrische Schaltgeräte zeichnen sich durch eine kleine Bauweise, hohe Funktionssicherheit und große Lebensdauer aus. Diese Merkmale hängen zum wesentlichen Teil von der Gestaltung der elektrischen Kontakte, insbesondere von der Auswahl des Kontaktwerkstoffes ab. Für Schaltgeräte, die Ströme im Bereich 50 A bis 3000 A zu schalten haben, hat sich in den letzten Jahren ein Werkstoff aus einer Silberlegierung mit Metalloxianteilen als optimal erwiesen. Eine besonders hervorzuhebende Gruppe ist hierbei eine Silber-Cadmiumoxid-Legierung.

Derartiges Kontaktmaterial kann auf verschiedene Art und Weise hergestellt werden. So kann eine Silber-Unedelmetall-Legierung durchoxidiert werden, oder es können auch oxidierte Silber/Unedelmetall-Partikel durch Pressen, Sintern und gegebenenfalls Nachprägen zusammengefügt werden. Im ersten Fall kann durch gezieltes Abbrechen des Oxidationsvorganges erreicht werden, daß die Unterseite des Silber/Unedelmetall-Blechtes beziehungsweise eines entsprechenden Blockes frei von Metalloxi-Anteilen bleibt, so daß diese Unterseite ohne Schwierigkeiten zu verlöten oder zu verschweißen ist. Bei dem aus oxidierten Silber/Unedelmetall-Partikeln zusammengeführten Material ist dies jedoch nicht möglich. Hier muß nachträglich die Unterseite so bearbeitet werden, daß ein Verlöten oder Verschweißen des aus diesem Material gefügten Kontaktes möglich ist.

Bei der pulvermetallurgischen Herstellung von Silber/Metalloxi-Werkstoffen, bei der die oxidierten Silber/Unedelmetall-Partikel durch Pressen, Sintern und Nachprägen zusammengefügt werden, kann eine ausgeprägte faserförmige (spießige) Anordnung der im Silber eingelagerten Oxide durch Strangpressen erreicht werden. Dabei werden die aus dem zugrundeliegenden Silber/Metalloxi-pulver in bekannter Weise durch Pressen und Sintern hergestellten Rohlinge mit hohem Umformgrad zu stangenförmigem Halbzeug stranggepreßt. Die Oxidteilchen ordnen sich dabei in Preßrichtung faserförmig, parallel zur Stabachse (Längsrichtung) des Halbzeugs an. Je nach Größe, Art und Beschaffenheit werden die Oxide außerdem beim Umformprozeß in Längsrichtung ver-

formt und/oder in kleinere Partikel zerteilt. Es hat sich gezeigt, daß die Eigenschaften dieser Silber/Metalloxi-Werkstoffe abhängig sind von der Orientierung der Metalloxi-Fasern zur Kontakt-oberfläche.

Die für Schaltgeräte der Energietechnik benötigten Kontaktplättchen werden so aus dem Halbzeug abgetrennt, daß die Faserrichtung der Oxide entweder parallel oder senkrecht zur späteren Kontakt-oberfläche liegt. Aus zahlreichen Untersuchungen ist bekannt, daß die Schalteigenschaften der Kontaktplättchen, insbesondere der Materialabbrand, bei Anordnung der Fasern senkrecht zur Schaltfläche, wesentlich günstiger sind als bei paralleler Ausrichtung. Dieser Effekt ist umso größer, je ausgeprägter die Faserstruktur der Oxide ist. Insbesondere auch an Kontaktwerkstoffen, die in einem Reaktions-Sprüh-Verfahren, beispielsweise nach der DE-PS 29 29 630, hergestellt worden sind, wurde dieser Anisotropieeinfluß in verstärktem Maße beobachtet. Bei derart, auf wirtschaftliche Art und Weise, hergestellten Kontakten, ist es deshalb zur Erzielung eines verringerten Kontaktmaterialabbrands beziehungsweise einer Silbereinsparung zweckmäßig, Kontaktplättchen mit senkrecht zur Schaltfläche orientierter Oxidfaser-richtung herzustellen.

Es wurde schon erwähnt, daß infolge des hohen Metalloxi-gehaltes, der im allgemeinen über 5 Gew.% liegt, derartige Kontaktplättchen nicht direkt auf einen Kontaktträger, der im allgemeinen aus Kupfer oder einer Kupferlegierung besteht, auflötbar oder aufschweißbar sind. Um trotzdem eine Löt-beziehungsweise Schweißbefestigung der Kontaktplättchen auf ihren Kontaktträgern zu ermöglichen, muß auf der Unterseite der Kontaktplättchen eine Schicht erzeugt werden, die weitgehend frei von Metalloxi-Anteilen ist.

Dem Stande der Technik zuzuzählen sind hierbei Verfahren, die die Unterseite der Kontaktplättchen mit einer löt- und schweißfähigen Schicht abdecken. Da das Aufbringen dieser Schicht jedoch weitgehend einem Auflöten beziehungsweise einem Aufschweißen entspricht, ist es selbstverständlich mit den gleichen Schwierigkeiten behaftet wie das Aufbringen der Kontaktplättchen auf ihre Kontaktträger. Tatsächlich kann sich diese Schicht unter extremen Bedingungen vom Kontaktplättchen lösen, wodurch der Kontakt selbstverständlich unbrauchbar wird.

Die Erfindung hingegen geht einen anderen Weg dadurch, daß das Material des Kontaktplättchens auf seiner Unterseite in reduzierender Atmosphäre mittels eines überstreichenden Laserstrahls kurzzeitig oberflächlich aufgeschmolzen wird

und sich damit eine einstückig mit dem Kontaktplättchenmaterial verbundene metalloxydfreie Schicht, die sowohl das Löten wie auch das Schweißen ermöglicht, ausbildet. Diese metalloxydfreie Schicht kann sich nicht mehr von dem Kontaktplättchenmaterial lösen, so daß derart behandelte Kontaktplättchen sicher und auch unter extremen Bedingungen fest mit einem Kontaktträger zu verbinden sind.

Um ein einwandfreies Löten beziehungsweise Schweißen zu ermöglichen, wird nach der Erfindung vorgeschlagen, die Laserleistung so einzustellen, daß sich eine Aufschmelztiefe zwischen 0,1 mm und 0,5 mm ergibt. Diese Schmelze kommt nun in intensiven Kontakt mit der reduzierenden Atmosphäre - vorteilhafterweise Wasserstoffgas oder ein Wasserstoff/Stickstoff-Gasgemisch - wodurch das Metalloxyd zu Metall reduziert wird, ohne daß sich hierbei der Verbund zu dem Kontaktplättchenmaterial löst.

Als Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach der Erfindung wird ein von einem reduzierenden Gas oder Gasgemisch durchströmter Arbeitsraum vorgeschlagen, in dem eine einen Laserstrahl aussendende Einrichtung angeordnet ist, die den Laserstrahl rasterförmig über die Unterseite der im Arbeitsraum untergebrachten Kontaktplättchen führt. Gleiche Ergebnisse werden selbstverständlich auch dann erzielt, wenn die den Laserstrahl aussendende Einrichtung sich außerhalb des Arbeitsraumes befindet, aber in ihn über ein für den Laserstrahl durchlässiges Fenster hineinwirkt oder über Lichtwellenleiter zu den Kontaktplättchen geleitet wird. In dem Arbeitsraum können die Kontaktplättchen auf einem Träger angeordnet sein; zweckmäßigerweise werden die Kontaktplättchen jedoch auf ein, den Arbeitsraum durchwanderndes Band, aufgelegt.

Die Lasereinrichtung kann im Impuls- oder im Dauerstrichbetrieb betrieben werden. Für diesen Zweck können grundsätzlich Gas-, Festkörper-, Flüssigkeits- oder Halbleiterlaser eingesetzt werden. Aufgrund des erforderlichen Leistungsbereichs sind bei der Bearbeitung größerer Kontaktplättchen in der Regel CO₂-Laser oder Festkörperlaser (YAG-Laser oder Glaslaser) erforderlich. Maßgebend ist lediglich, daß die oben beschriebene Aufschmelztiefe erreicht wird, ohne daß sich das restliche Kontaktplättchenmaterial wesentlich erwärmt. Wird ein im Impulsbetrieb geführter Laser verwendet, so sollen zweckmäßigerweise die punktförmigen Aufschmelzzonen so dicht beieinander liegen, daß sich praktisch ein die gesamte Oberfläche des Kontaktplättchens überstreichendes Linienraster ergibt. Dabei läßt sich die Größe und Tiefe der aufgeschmolzenen Bereiche sowohl durch die Energiedichte und Dauer der Laserimpulse (bei Impulsbetrieb) beziehungsweise Geschwindigkeit des

Laserstrahls (bei Dauerstrichbetrieb) als auch die Beschaffenheit der aufzuschmelzenden Oberfläche beeinflussen. Als besonders günstig hat es sich hierbei erwiesen, mit defokussiertem Laserstrahl auf eine aufgerauhte oder künstlich geschwärzte Oberfläche zu strahlen.

Auf der Zeichnung sind schematisch zwei Vorrichtungen zur Durchführung des Verfahrens dargestellt, und zwar zeigen:

Fig. 1 einen Laserstrahl mit Umlenkung und
Fig. 2 einen aufgeweiteten Laserstrahl.

In einem geschlossenen Arbeitsraum (1) befinden sich auf einer Unterlage beziehungsweise einem den Arbeitsraum (1) durchwandernden Band (2) Kontaktplättchen (3), die mit der Unterseite nach oben auf das Band (2) aufgelegt sind. Der Arbeitsraum wird, wie durch die Pfeile (4, 5) angedeutet, von einem reduzierenden Gas oder einem entsprechenden Gasgemisch durchströmt, so daß der gesamte Arbeitsraum (1) von diesem durchströmenden Gas beziehungsweise Gasgemisch gefüllt ist. Über ein laserstrahldurchlässiges Fenster (6) wird ein Laserstrahl (7) geführt, der über eine Umlenkeinrichtung (8) - beispielsweise einen Spiegel (8) -, wie durch die Pfeile (9, 10) angedeutet, rasterförmig über die Kontaktplättchen (3) geführt wird. Hierbei wird das Material der Unterseite der Kontaktplättchen (3) kurzzeitig aufgeschmolzen und in der reduzierenden Atmosphäre reduziert, wodurch sich eine lötfähige, zwischen 0,1 mm und 0,5 mm liegende Schicht ergibt.

Fig. 2 zeigt eine Vorrichtung mit aufgeweiteten Laserstrahl (17), der in der Darstellung nach Umlenkung durch den Spiegel (8) die gesamte aufzuschmelzende Oberfläche des Kontaktplättchens (3) erreicht. Zusätzlich ist auch hier noch eine Düse (11) vorgesehen, die gezielt reduzierendes Gas (14) auf die aufzuschmelzende Oberfläche des Kontaktplättchens (3) führt.

Ansprüche

1. Verfahren zum Ausbilden einer lötfähigen oder schweißfähigen Schicht auf der Rückseite (Unterseite) eines Silber/MeO-Kontaktplättchens mit Me-Anteilen, vorzugsweise aus Cadmium, Zinn, Zink, Kupfer, Wismut, Molybdän, Wolfram oder Indium, bei dem die MeO-Partikel faserförmig (spießig) ausgebildet sind und mit ihrer Faserlängsrichtung etwa senkrecht zur Kontaktfläche liegen, dadurch gekennzeichnet, daß das Material in reduzierender Atmosphäre (4, 5) mittels eines Laserstrahls (7) kurzzeitig oberflächlich aufgeschmolzen wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß als reduzierende Atmosphäre (4, 5) Wasser-
stoffgas oder ein Wasserstoff/Stickstoff-Gasgemisch eingesetzt wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Oberfläche des aufzuschmelzenden Mate-
rials durch einen Bearbeitungsvorgang wie Schlei-
fen, Bürsten, Schmirgeln, Sandstrahlen o.ä. aufge-
raut wird, um die Reflexion der Oberfläche zu
verringern.

4. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Oberfläche des aufzuschmelzenden Mate-
rials durch gezielte Schwärzung vorbehandelt wird,
um die Reflexion der Oberfläche zu verringern.

5. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Laserleistung je nach Strahlquerschnitt, Im-
pulsdauer beziehungsweise Strahlgeschwindigkeit
und der Oberflächenbeschaffenheit der zu bearbei-
tenden Oberfläche so eingestellt wird, daß sich
eine Aufschmelztiefe zwischen 0,1 mm und 0,5
mm ergibt.

6. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Oberfläche mit defokussiertem beziehungs-
weise künstlich aufgeweitetem Laserstrahl aufges-
chmolzen wird, wobei die Aufweitung je nach Lei-
stung des Lasers so groß gewählt wird, daß nur ein
Bruchteil oder aber auch die gesamte Kontaktplätt-
chenoberfläche gleichzeitig vom Laserstrahl erfaßt
wird.

7. Verfahren nach den Ansprüchen 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Laserstrahl je nach Strahlquerschnitt des
aufgeweiteten Strahls entweder die gesamte Kon-
taktoberfläche gleichzeitig erfaßt oder diese ra-
sterförmig überstreicht.

8. Vorrichtung zur Durchführung des Verfah-
rens nach den vorherigen Ansprüchen,
gekennzeichnet,
durch einen von einem reduzierenden Gas oder
Gasgemisch (4, 5) durchströmten Arbeitsraum (1)
und einer im Arbeitsraum (1) angeordneten oder in
den Arbeitsraum (1) hineinwirkenden, einen Laser-
strahl (7) aussendenden Einrichtung, die den Laser-
strahl (7) über einen Umlenkspiegel (8) auf die
Oberfläche der auf der Unterseite des Arbeitsrau-
mes (1) angeordneten Kontaktplättchen (3) führt.

9. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß die Kontaktplättchen (3) auf einem den Arbeits-
raum (1) durchwandernden Band (2) angeordnet
sind.

10. Vorrichtung nach Anspruch 8,
dadurch gekennzeichnet,
daß der Laser (7) ein Impulslaser oder ein Dauer-
strichlaser ist.

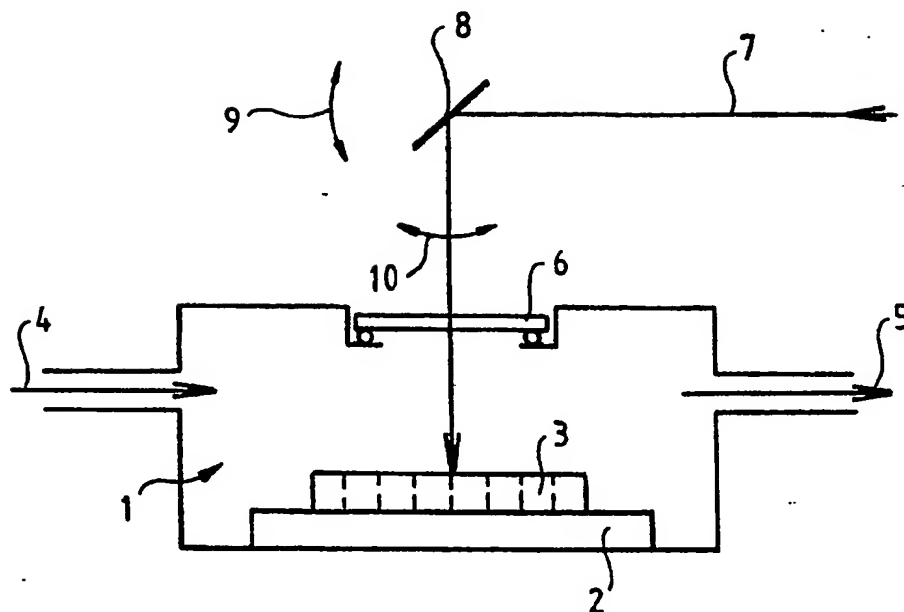


Fig. 1

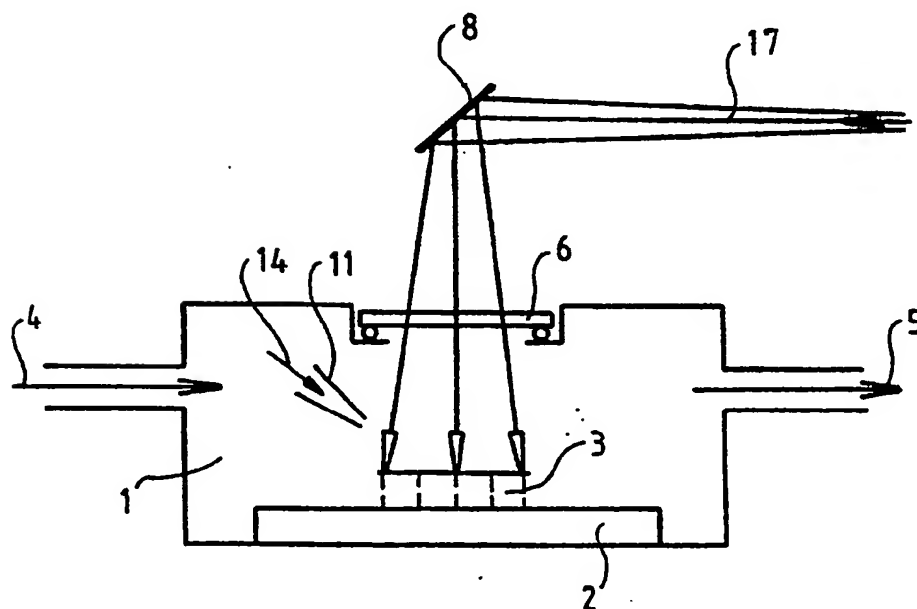


Fig. 2



Europäisches
Patentamt

EUROPÄISCHER RECHERCHENBERICHT

Nummer der Anmeldung

EP 87 10 4367

EINSCHLÄGIGE DOKUMENTE			
Kategorie	Kennzeichnung des Dokuments mit Angabe, soweit erforderlich, der maßgeblichen Teile	Betrifft Anspruch	KLASSIFIKATION DER ANMELDUNG (Int. CL.4)
Y	EP-A-0 182 182 (SIEMENS AG) * Spalte 2, Zeilen 27-31; Spalte 3, Zeile 26 - Spalte 4, Zeile 44; Figuren 1, 2 *	1	H 01 H 1/02 H 01 H 11/04 B 23 K 1/20
A	----	3,5,7,9,10	
Y	US-A-4 636 270 (A. SHIBATA) * Spalte 2, Zeilen 45-65 *	1	
A	DE-A-2 941 423 (DEGUSSA AG) * Anspruch 1 *	1,2	
A	US-A-4 162 390 (T.J. KELLY) * Anspruch 1; Figur *	8	
A	DE-B-2 351 226 (FA. G. RAU) * Anspruch 1; Figur 3 *	1	
A	EP-A-0 067 983 (DEGUSSA AG) -----		
			RECHERCHIERTE SACHGEBIETE (Int. CL.4)
			H 01 H 1/00 H 01 H 11/00 B 23 K 1/20
Der vorliegende Recherchenbericht wurde für alle Patentansprüche erstellt			
Recherchenort BERLIN		Abschlußdatum der Recherche 16-11-1987	Prüfer RUPPERT W
KATEGORIE DER GENANNTEN DOKUMENTE		T : der Erfindung zugrunde liegende Theorien oder Grundsätze E : älteres Patentedokument, das jedoch erst am oder nach dem Anmeldedatum veröffentlicht worden ist D : in der Anmeldung angeführtes Dokument L : aus andern Gründen angeführtes Dokument & : Mitglied der gleichen Patentfamilie, übereinstimmendes Dokument	
X : von besonderer Bedeutung allein betrachtet Y : von besonderer Bedeutung in Verbindung mit einer anderen Veröffentlichung derselben Kategorie A : technologischer Hintergrund O : mündliche Offenbarung P : Zwischenliteratur			